

Plaskon 7115

Епоху; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is a standard epoxy molding compound used for the encapsulation of a variety of semiconductor devices ranging from small lead count DIPs to medium lead count PLCCs, to Transistors and SOICs. It was especially developed for balanced end use properties.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Лазерная маркировка Хорошая производительность формования Отличный внешний вид		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.89	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1.38	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	0.0138	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	165	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	2.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	20	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	20	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	3.50		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	0.010		ASTM D150
Дуговое сопротивление	180	sec	ASTM D495
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0		UL 94
Дополнительная информация			

Recommended Storage Temperature: 5°C Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 24 months Life @ 21°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 3 days Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days Spiral Flow, 177°C, 1000 psi: 77 cm Automatic Orifice Viscosity, 175°C, Shear Rate is 157000 sec⁻¹, 1 mm die length, 1/2 mm diameter: 35 Pascal sec Ram Follower Gel Time, 177°C: 16 sec Ash Content: 72 % Hydrolyzable Halides: 10 ppm Cull Hot Hardness, Shore D, 90 sec, 175°C: 85 Arc Resistance, 110v AC 180 sec All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C
Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 22 cm⁻⁶/cm/°C
Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 63 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Preheat Temperature: 90 to 100°C

Molding Temperature: 170 to 190°C

Molding Pressure: 1000 psi

Cure Time, 177°C: 60 to 90 min

Post Mold Cure Time, 175°C: 4 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat